**集成电路材料全国重点实验室**

**开放课题申请书**

**课题名称：**

**课题编号：暂无**

**课题负责人：**

**承担单位：**

**课题执行时间：2025年7月-2027年6月**

**集成电路材料全国重点实验室开放课题申请书**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **课题名称** | |  | | | | | | | |
| **申请经费额度** | | 万元 | | 研究期限 | | | 年 | | |
| **课题类型** | | □ 大硅片及相关基础研究  □ SOI材料应用  □ 异质集成衬底材料研发（XOI异质集成材料、超导材料、半导体相变材料等）  □ 晶圆级工艺与封装材料研发  □ 集成电路材料前沿技术研究（拓扑材料、二维材料、量子材料等） | | | | | | | |
| **负**  **责**  **人** | 姓名 | 性别 | 职称 | 所学专业 | | 最后  学位 | | 学位取得时间 | 授予单位 |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
| 证件类型 | 证件号码 | | | 国别 | 出生日期 | | 电子邮箱 | |
|  |  | | |  |  | |  | |
| 工作单位 | | 通信地址 | | | | | 邮政  编码 | 手机 |
|  | |  | | | | |  |  |
| **立项意义，研究内容,技术路线和年度计划：** | | | | | | | | | |
| **协同合作设想：** | | | | | | | | | |
| **现有工作基础（**着重描述课题负责人近五年与本课题有关的科研成果，包括但不限于第一/通讯作者学术论文、第一申请人专利、技术文档等**）：** | | | | | | | | | |
| **平台条件：** | | | | | | | | | |
| **预期年度成果：** | | | | | | | | | |
| **经费预算**   |  |  | | --- | --- | | **分类** | **经费** | | 材料费 |  | | 测试加工费 |  | | 差旅费 |  | | 会议费 |  | | 出版、文献、信息传播、知识产权 |  | | 专家咨询 |  | | 劳务费 |  | | 高级访问学者费 |  | | 其他费用 |  | | 合计 | 万 | | | | | | | | | | |
| 申请人所在单位意见：  公章  年 月 日 | | | | | | | | | |
| 实验室学术委员会审核意见：  年 月 日 | | | | | | | | | |
| 备注 |  | | | | | | | | |